

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] No. 211] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2015/श्रावण 19, 1937

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015 /SRAVANA 19, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

(आईपीएचडब्ल्यू प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2015

विषय: संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स): कार्यक्षेत्र का विस्तार और समयावधि बढ़ाना तथा अन्य संशोधन- संशोधित अधिसूचना

- सं. 27(35)/2013 -आईपीएचडब्ल्यू संदर्भः
- 1. दिनांक 27-07-2012 की राजपत्र अधिसूचना सं.175 के अंतर्गत अधिसूचित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स)।
- 2. दिनांक 07-10-2012 की अधिसूचना सं.27(3)/2012-आईपीएचडब्ल्यू के अंतर्गत संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के लिए दिशानिर्देश और उनमें दिनांक 23-05- 2013 एवं 23-12-2013 को किए गए संशोधन ।
- 3. दिनांक 14-01-2013 की अधिसूचना सं 36(3)/2012-आईपीएचडब्ल्यू के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में एम-सिप्स के अंतर्गत अधिसूचित ब्राउनफील्ड कलस्टरों के लिए दिशानिर्देश।
- 4. दिनांक 07-05-2014 की अधिसूचना सं 36(14)/2014- आईपीएचडब्ल्यू के जरिए "एम-सिप्स के प्रयोजन से अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कलस्टरों" के रूप में ईएसडीएम के लिए एम-सिप्स योजना के अंतर्गत ब्राउनफील्ड कलस्टरों को अधिसूचित करने के लिए दिशानिर्देशों का पुनर्निर्धारण।

3402 GI/2015 (1)

उपर्युक्त संदर्भ सं. (1) में उल्लिखित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-सिप्स) को 27 जुलाई, 2012 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया। उपर्युक्त संदर्भ सं. (2) में उल्लिखित कार्यान्वयन दिशानिर्देश भी प्रकाशित किए गए हैं। ऐसे क्षेत्रों/कलस्टरों जिनके लिए एम-सिप्स के अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, के लिए आवश्यक दिशानिर्देश उपर्युक्त संदर्भ सं. (3) और (4) के जरिए जारी किए गए हैं।

2. योजना के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न उद्योग संघों, संभावित आवेदकों और अन्य पणधारकों से योजना में निवेश के संदर्भ में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों की जांच की गई है और सभी पणधारकों के साथ चर्चा की गई है। इसके आधार पर संशोधित सिप्स नीति में संशोधनों का प्रस्ताव है। अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे।

3. अतिरिक्त वर्टिकल के लिए एम-सिप्स लाभों का विस्तार:

एम-सिप्स लाभ उपर्युक्त संदर्भ सं. (1) में उल्लिखित वर्टिकलों के लिए उपलब्ध हैं। उन वर्टिकलों की सूची का विस्तार करने का विचार है जिनके लिए एम-सिप्स लाभ उपलब्ध हैं। इस अधिसूचना के अनुलग्नक (1) अतिरिक्त सूची उपलब्ध है।

4. प्रक्रिया का सरलीकरण

- 4.1 योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से उपलब्ध होगा, बशर्ते कि इस प्रकार परिकलित अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रत्याशित आधार (अर्थात अधिसूचना की तारीख से) पर होने चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, 10 वर्ष की अवधि, जिसके लिए प्रोत्साहन का दावा करने हेतु कोई आवेदक पात्र है, की गणना भी आवेदन की तारीख से की जाएगी। परंतु, किसी यूनिट को प्रोत्साहन केवल तभी दिए जाएंगे जब वह योजना के अंतर्गत आवश्यक थ्रेशहोल्ड निवेश का लक्ष्य प्राप्त कर लेती है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना अनुमोदित कर दी जाती है।
- 4.2 उद्योगों से प्राप्त अन्य इनपुट के आधार पर विभिन्न उद्योग यूनिटों के लिए संशोधित थ्रेशहोल्ड सीमाओं का निर्धारण करने का प्रस्ताव है, जिनके लिए यूनिट इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन हेतु पात्र होगी। सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए संशोधित थ्रेशहोल्ड इस अधिसूचना के अनुलग्नक 2 में दी गई हैं।
- 4.3 एनॉलॉग/मिक्स्ड सिग्नल सेमीकंडक्टर चिप, पावर सेमीकंडक्टर, ओएलईडी, एलसीडी (एलसीडी फेब्रिकेशन और ग्लास सबस्ट्रेट) के फेब्रिकेशन और एटीएमपी, चिप संघटकों का फेब्रिकेशन, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर, एसपीवी (पॉलीसिलिकॉन, इंगॉट और/अथवा वेफर, सेल), एलईडी और पीसीबी के विनिर्माण, नैनो-इलेक्ट्रॉनिक संघटकों और एलसीएम के लिए उत्पादन कारोबर (एक्स फैक्टरी) के 10% की दर से उत्पादन आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्रदान करने का प्रस्ताव है। इसे प्रचालनात्मक प्रोत्साहन के रूप में शुरू करने का इरादा है। सेमीकंडक्टर वेफरिंग, लॉजिक माइक्रोप्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (डीएसपी) और एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटिड सर्किट (एएसआईसीएम), मेमोरी, एलसीडी फेब्रीकेशन के लिए "केंद्रीय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति" के मौजूदा प्रावधान को "उत्पादन टर्नओवर (एक्स फैक्ट्री) के @ 10 % उत्पादन सब्सिडी के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।
- 4.4 एम-सिप्स के लिए प्रोत्साहनों का संवितरण निवेश की थ्रेशहोल्ड सीमा का लक्ष्य प्राप्त करने के तुरंत बाद किया जाएगा। तत्पश्चात संवितरण तिमाही आधार पर किया जाएगा।
- 4.5 यह योजना केंद्र/राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किसी औद्योगिकी क्षेत्र में अवस्थित मूल्यांकन समिति द्वारा यथामूल्यांकित किसी व्यवहार्य यूनिट के लिए उपलब्ध होगी। उन क्षेत्रों, जो प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे, को अधिसूचित करने की पद्धित को एतद्द्वारा छोड़ दिया गया है। अलग तकनीकी मूलयांकन समितियां गठित करने की भी पद्धित छोड़ दी जाएगी।
- आवेदनों के लिए समयाविध बढ़ाना
- 5.1 संशोधित योजना के अंतर्गत आवेदन करने की समयाविध को जुलाई, 2015 में योजना की चालू अविध के समाप्त होने के बाद 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है।

6. एम-सिप्स नीति में संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिशानिर्देशों का एक अलग सेट जारी किया जाए।

डॉ. अजय कुमार, अपर सचिव

अनुलग्नक_1

ईएसडीएम वर्टिकल/परियोजनाओं की अतिरिक्त सूची जिनके लिए एम-सिप्स के अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध हैं :-

r	
(क)	इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद <u>(अनुलग्नक</u> 2 का क्र.सं 1) :
1	दूरसंचार उत्पाद : ऑप्टिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर केबल, हेडेन्ड्स
2	आईटी हार्डवेयर उत्पाद : ऑटोमेटिक टेलर मशीन (एटीमए), आदि *
3	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी: ऑडियो वीडियो उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक घृडियां और दीवार घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, निजी देखरेख वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद आदि*
4	ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिकी : ब्रशयुक्त डीसी मोटर्स *, आदि
5	बॉयो-मीट्रीक और पहचान उपकरण/आरएफआईडी : स्मार्ट कार्ड विनिर्माण और वैयक्तिकरण*
6	उपभोक्ता उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, फुली ऑटोमेटिक वांशिग मशीन, माइक्रोवेव ओवन आदि
7	पीसीबी डिजाइन सहित इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद डिजाइन
8	मशीन से मशीन (एम2एम) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) उत्पाद
9	होम फ्यूल सेल
10	बहुत कार्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
11	सेमीकंडक्टर उपकरण जैसे ऑटोमेटिक टेस्ट हैंडलर, पिक एंड प्लेस मशीन, टेस्ट हैड मनीपुलेटर और उनकी सहायक उपकरण जैसे टेस्ट सॉकिट, प्रोब कार्ड, एटीई लोड बोर्ड, कंवरजन किट, डॉकिंग मैकेनिज्म
12	इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण – जिसमें सीसीटीवी/निगरानी उपस्कर, सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल, इन्ट्रूडर अलार्म आदि शामिल हैं।
(ख)	मध्यस्थ्य (अनुलग्नक 2 का क्र.सं. 2)
1	इलेक्ट्रो-प्लेटिंग, स्माल प्रिसिज़न प्लास्टिक और मैटल पार्ट्स, टूल, मोल्डस और डाई
2	लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल (एलसीएम)
3	ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डॉयोड (ओएलईडी)
4	स्मार्ट कार्डों के लिए चिप मॉड्यूल
5.	एनॉलॉग/मिक्स्ड सिग्नल सेमीकंडक्टर चिप्स
ग	इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए पूंजीगत उपस्कर
घ	इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए विशिष्ट कच्चा माल
ड.	इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का पुनर्विर्माण

^{*} ये वर्टिकल दिनांक 27-07-2012 की अधिसूचना में पहले से मौजूद हैं और अतिरिक्त उत्पादों को शामिल करने के लिए इन्हें एम्प्लीफाई किया गया है।

<u>अनुलग्नक 2</u>

संशोधित निवेश थ्रेशहोल्ड और वित्तीय प्रोत्साहन

			निवेश थ्रेशहो (करोड़ रुपए		विर	वित्तीय प्रोत्साहन		
क्र.सं.	प्रकार	फैब	असेंबली, परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)	विनिर्माण	सेज	नॉन-सेज		
1	इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद	-	-	10	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति		
2	माध्यस्थ							
2.1	नैनो इलेक्ट्रॉनिक संघटक	_	-	200	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%		
2.2	सेमीकंडक्टर वेफरिंग	-	-	1000	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%		
2.3	सेमीकंडक्टर चिप :							
क)	लॉजिक — माइक्रोप्रोसर, माइक्रोकंट्रोलर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (डीएसपी) और एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटिड सर्किट (एएसआईसीएस)	2000	100	लागू नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%		
ख)	एनालॉग /मिक्स्ड सिगनल	1000	100	लागू नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति		

						का 10%	+ उत्पादन टर्नओवर (एक्स-
							फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
ग)	मेमोरी	5000	200	लागू	नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
2.4	चिप संघटक, डिस्क्रीट सेमीकंडटर	और पावर	सेमीकंडक्टर	•			
क)	चिप संघटक	200	लागू नहीं	लागृ	् नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
		लागू नहीं	10			कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
ख)	डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर जैसे ट्रॉजिस्टर, डायोड आदि	25	लागू नहीं	लागृ	् नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
		लागू नहीं	10	लागृ	् नहीं	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
ग)	पावर सेमीकंडक्टर (डिफ्यूजन सहित) जैसे एफईटी, एमओएसएफईटी, एससीआर, जीटीडी, आईजीबीटी आदि	100	50	लाग्	् नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
2.5	सोलर फोटोवोल्टेइक (एसपीवी):			•			
i)	पॉलिसिलिकॉन	50	0 लागू	नहीं	लागू	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत

	T	T	1	· ·	Ī	· ·
				नहीं	+ उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
ii)	इंगोट्स और /अथवा वेफर	150	लागू नहीं	लागू नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
iii)	सेल	75	लागू नहीं	लागू नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
iv)	मॉड्यूल /पैनल	लागू नहीं	लागू नहीं	10	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
2.6	लाइट एमिटिंग डायोड (एलईडी)	150	लागू नहीं	लागू नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादनसब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
			10		कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स-फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
2.7	ऑग्रेनिक लाइट एमिटिंग डायोड (ओएलईडी)	600	100	लागू नहीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
2.8	स्मार्ट कार्डों के लिए चिप मॉड्यूल	लागू नहीं	10	लागू नहीं	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + उत्पाद शुल्क/पूंजीगत उपस्करों पर सीवीडी की प्रतिपूर्ति

[भाग I-खण्ड 1] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

2.9	लिक्किड क्रिस्टल डिस्प्लेयर (एलसीडी):											
क)	एलसीडी फेब्रीकेशन	1500	2	250		गू शि	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%				
ख)	एलसीडी ग्लास सबस्ट्रेट	250	1	100						ागू हीं	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
ग)	लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल (एलसीएम)	लागू नहीं	लाः	लागू नहीं		πगू नहीं		लागू नहीं		50	कैपेक्स का 20% + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%
2.9	निष्क्रिय संघटक, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कं	पोनेंट, मैवे	। हिनक	ल कलपु	र्भे औ	र खपत	योग्य सामग्री और सह	हायक उपकरण :				
क)	निष्क्रिय संघटक जैसे प्रतिरोधक, कैपेसिटर, इंडप्टर, थर्मिस्टर आदि	लागू नः	ट ीं	लागू नः	हीं	5	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति				
ख)	इलेक्ट्रो-मैकेनिकल कंपोनेंट और मैकेनिकल कलपुर्जे जैसे ट्रांसफार्मर, क्वाइल, कनेक्टर, स्विच, फैराइट, माइक्रो मोटर, स्टेपर मोटर, फिल्म, स्माल प्रिसिजन प्लास्टिक और मैटल पार्ट, टूल, मोल्ड और डाई आदि	लागू नः	हीं लागूनः		हीं	5	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति				
ग)	प्रिंटिट सर्किट बोर्ड	लागू नः	हीं	लागू नः	हीं	5	कैपेक्स का 20%+ उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति + उत्पादन टर्नओवर (एक्स- फैक्ट्री) पर उत्पादन सब्सिडी का 10%				

घ)	खपत योग्य सामग्री और सहायक उपकरण जैसे मोबाइल फोन और आईटी उपकरण – बैटरी, चार्जर आदि, फ्वाइल, टेप, एपॉक्सी कैबिनेट आदि	लागू नहीं	लागू नहीं	1	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
3.	इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सेवाएं (ईएमएस)	लागू नहीं	लागू नहीं	10	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
4.	इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए पूंजीगत उपस्कर	लागू नहीं	लागू नहीं	10	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
5.	विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कच्चा माल	लागू नहीं	लागू नहीं	5	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
6.	बॉयोमीट्रिक और पहचान संबंधी उत्पाद/आरएफआईडी/स्मार्ट कार्ड विनिर्माण और वैयक्तिकरण	लागू नहीं	लागू नहीं	5	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति
7.	इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का पुनर्विर्माण (नोट-1 देखें)	लागू नहीं	लागू नहीं	5	कैपेक्स का 20%	कैपेक्स का 25% + पूंजीगत उपस्करों पर उत्पाद शुल्क/सीवीडी की प्रतिपूर्ति

नोट 1 :_प्रोत्साहन विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) और किसी अन्य संगत मौजूदा नीति के अनुपालन के अध्यधीन और केवल तभी प्रदान किए जाएंगे जब प्रतिपूर्ति प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद का पुन: निर्यात किया जाएगा।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2015

Subject: Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS): Enhancement of scope and extension of timeline and other amendments - Revised Notification

No. 27(35)/2013-IPHW.—References:

- 1. Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) Policy Gazette Notification vide no. 175 dated 27-07-2012.
- 2. Guidelines for Modified Special Incentive Package Scheme vide no. 27(3)/2012-IPHW dated 07-10-2012 and Amendment dated 23-05-2013 & 23-12-2013
- 3.. Guidelines for notifying Brownfield Clusters under M-SIPS in the Electronics Systems Design and Manufacturing (ESDM) Sector vide no. 36(3)/2012-IPHW dated 14-01-2013
- 4. Renaming of Guidelines for notifying Brownfield Clusters under M-SIPS scheme for ESDM as "Notified Electronics Manufacturing Clusters for the purpose of M-SIPS" vide no. 36(14)/2014-IPHW dated 07-05-2014

The policy for Modified Special Incentive Package Scheme (Modified-SIPS) cited as reference (1) above was notified in the Gazette on July 27th, 2012. The implementation guidelines cited as reference (2) above have also been published. Necessary guidelines for notifying areas/clusters in which the incentives under Modified SIPS is available have been issued vide reference cited as (3) and (4) above.

2. Various representations have been received from industry associations, potential applicants and other stakeholders regarding improvements in the scheme. These suggestions have been examined and detailed consultations have been held with all stakeholders. Based on the same, the following amendments are proposed in the Modified SIPS policy. All other provisions remain unchanged.

3. Extending Modified SIPS benefits to additional verticals

3.1 The M-SIPS incentives are hitherto available to the verticals as mentioned in reference (1) above. It is proposed to expand the list of verticals for which Modified SIPS will be available. The additional list is at **Enclosure** 1 of this notification.

4. Simplifying process

- 4.1 The incentives under the scheme will be available from the date of receipt of application subject to the condition that the additional incentives so calculated should be on a prospective basis (i.e. from the date of notification). Consequently, the period of 10 years for which an applicant is eligible for claiming incentives shall also be reckoned from the date of application. However, the incentives will be given to a unit only after it achieves threshold investment as required under the scheme and approval of the project by Competent Authority.
- 4.2 Based on further industry inputs, the revised thresholds for various industry units are proposed for unit to be eligible for incentives under the scheme. The revised thresholds for all project types are at **Enclosure 2** of this notification.
- 4.3 It is proposed to introduce Production Subsidy @ 10 % of the production turnover (ex-factory) for Fabrication and ATMP of Analog/Mixed signal semiconductor chips, Power Semiconductors, OLEDs, LCD (LCD fabrication & glass substrate), Fabrication of Chip Components, Discrete Semiconductors, SPV (Polysilicon, ingots and/or wafers, cells), LEDs and Manufacturing of PCBs, nano-Electronic components and LCM. It is intended as an operational incentive. The existing provision of "reimbursement of Central Taxes and Duties" for Semiconductor Wafering, Logic Microprocessors, Digital Signal Processors (DSP) & Application Specific Integrated Circuits (ASICS), Memory, LCD Fabrication is proposed to be changed as "Production subsidy @ 10 % of the production turnover (ex factory".
- 4.4 The incentives for Modified SIPS will be disbursed immediately after the threshold of investment has been achieved. Thereafter, the disbursements will be made on quarterly basis.
- 4.5 The scheme will be available to any viable unit as appraised by Appraisal Committee located in any industrial area notified by Centre/State/local authority. The practice of notifying areas wherein the incentives will be eligible is hereby dispensed with. The practice of having separate Technical Evaluation Committees will also be dispended with.

5. Extension of Time Period for Applications

- 5.1 The time for making applications under the Revised Scheme is extended for a period of 5 years beyond the current expiry of the scheme in July, 2015.
- 6. For effective functioning of the revisions in the M-SIPS policy, a set of Guidelines may be issued by Department of Electronics and Information Technology separately.

Dr. AJAY KUMAR, Addl. Secv.

Enclosure 1

Additional List of ESDM verticals/projects for which incentives are available under M-SIPS

A	Electronics Products (SI no. 1 of Enclosure 2):
1	Telecom products: Optical Fibres and Optical Fibre Cables, Headends*
2	IT Hardware products: Automatic Teller Machines (ATMs), etc.*
3	Consumer Electronics: Audio Video products, electronic watches and clocks, electronic toys, wearable electronics, electronic personal care products, etc.*
4	Automotive Electronics: Brushed DC Motors*, etc.
5	Bio-metric and identity devices/RFID: Smart Card manufacturing and personalization*
6	Consumer Appliances like Refrigerators, ACs, Fully Automatic Washing Machines, Microwave Ovens, etc.
7	Electronic product design including PCB design

8	Machine to Machine (M2M) and Internet of Things (IoT) products
9	Home Fuel Cells
10	Multi-functional electronic devices
11	Semiconductor Equipment such as Automatic Test Handler, Pick & Place Machines, Test Head Manipulator and their accessories like Test Sockets, Probe Cards, ATE Load Boards, Conversion Kits, Docking Mechanisms
12	Electronic security devices- including CCTV/surveillance equipment, CCTV, Access Control, intruder alarms etc.
В	Intermediates (SI no. 2 of Enclosure 2)
1	Electro-plating, small precision plastic and metal parts, tools, moulds & dies
2	Liquid Crystal Module (LCM)
3	Organic Light Emitting Diodes (OLED)
4	Chip Modules for Smart Cards
5	Analog/Mixed Signal Semiconductor Chips
С	Capital Equipment for electronic products
D	Raw material exclusively for electronic products
E	Remanufacturing of electronic products

^{*} These verticals already exist in the notification dated 27-07 -2012 and have been amplified to include additional products.

Enclosure 2 Revised Investment Thresholds and Financial Incentives

		Investm	ent Threshold (in	n Rs Crore)	Financ	cial Incentives
Sl. No.	Туре	Fab	Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)	Manufacturing	SEZ	Non SEZ
1	Electronic Products	-	-	10	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
2	Intermediates					
2.1	Nano Electronic Components	-	-	200	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
2.2	Semiconductor Wafering	-	-	1000	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
2.3	Semiconductor Chips:					
a)	Logic — Microprocessors, Microcontrollers, Digital Signal Processors (DSP) & Application Specific Integrated Circuits (ASICS)	2000	100	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)

					20% of Capex + 10% of	25% of Capex + Reimbursement of
b)	Analog/Mixed Signal	1000	100	N.A.	Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
c)	Memory	5000	200	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
2.4	Chip Components, Discrete Se	miconductors	and Power Semi	conductors:	•	
a)	Chip Components	200	N.A.	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment+ 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
		N.A.	10		20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
b)	Discrete Semiconductors like Transistors, Diodes etc.	25	N.A.	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment+ 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
		N.A.	10	N.A.	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
c)	Power Semiconductors (including Diffusion) like FETs, MOSFETs, SCRs, GTDs, IGBTs etc.	100	50	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
2.5	Solar Photovoltaics (SPV):				•	
i)	Polysilicon	500	N.A.	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
ii)	Ingots and/or wafers	150	N.A.	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
iii)	Cells	75	N.A.	N.A.	20% of Capex + 10% of	25% of Capex + Reimbursement of

						Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
iv)	Modules/Panels	N.A	Α.	N.A.	10	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
2.6	Light Emitting Diodes (LED)	15	0		N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
				10		20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
2.7	Organic Light Emitting Diodes (OLED)	60	0	100	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
2.8	Chip Modules for Smart Cards	N.A	Α.	10	N.A.	20% of Capex	25% of Capex+ Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
2.9	Liquid Crystal Displays (LCD)):					I
a)	LCD Fabrication	150	00	250	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
b)	LCD Glass Substrate	25	0	100	N.A.	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment+10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
c)	Liquid Crystal Module (LCM)	N.A.		N.A.	50	20% of Capex + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
2.10	Passive Components, Electro -	Mecha	nical C	omponents, Med	chanicals Parts an	d Consumables & A	ccessories:
a)	Passive Components such as Resistors, Capacitors, Inductors, Thermistors etc.		N.A.	N.A.	5	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
b)			N.A.	N.A.	5	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of

	Electromechanical Components and Mechanical Parts such as Transformers, Coils, Connectors, Switches, Ferrites, Micro Motors, Stepper Motors, Films, small precision plastic and metal parts, tools, moulds & dies etc.					Excise/CVD on capital equipment
c)	Printed Circuit Boards	N.A.	N.A.	5	20% of Capex+ 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex- factory)	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment + 10% of Production Subsidy on Production turnover (Ex-factory)
d)	Consumables and Accessories such as Mobile Phones and IT accessories -Batteries, Chargers etc., Foils, Tapes, Epoxy, Cabinets etc.	N.A.	N.A.	1	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
3.	Electronic Manufacturing Services (EMS)	N.A.	N.A.	10	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
4.	Capital Equipment for electronic products	N.A.	N.A.	10	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
5.	Raw materials exclusively for electronic products	N.A.	N.A.	5	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment
6.	Bio-metric and identity products/RFID/Smart Card manufacturing and personalization	N.A.	N.A.	5	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment.
7.	Remanufacturing of electronic products (refer Note 1)	N.A.	N.A.	5	20% of Capex	25% of Capex + Reimbursement of Excise/CVD on capital equipment.

Note 1: Incentives will be provided subject to compliance of Foreign Trade Policy (FTP) and any other relevant existing policy and only if the re-manufactured electronic product is re-exported.